

台灣半導體科技教育協會第一期課程

第一週	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	2.3 薄膜技術與應用	業師輔導 互動交流	

台灣半導體科技教育協會第一期課程

第二週	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	考試	
20:55~ 21:40	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件 結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	考試	

台灣半導體科技教育協會第一期課程

第三週	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程 技術	業師輔導 互動交流	

台灣半導體科技教育協會第一期課程

第四週	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	3.4 SPC 統計制程式控制	3.5 FMEA 的觀念與應 用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	休息
19:15~ 20:00	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	3.4 SPC 統計制程式控制	3.5 FMEA 的觀念與應 用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	
20:10~ 20:55	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	業師輔導 互動交流	4.1 漫遊 IC 封裝世界 -入門級	4.3 記憶體測試	考試	
20:55~ 21:40	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	業師輔導 互動交流	4.1 漫遊 IC 封裝世界 -入門級	4.3 記憶體測試	考試	

台灣半導體科技教育協會第一期課程/第二期課程

TSTEA 台灣半導體科技教育協會秘書長 張卓浩 (籌備處) Taiwan Semiconductor Technology Education Association (Preparatory Office)
 E-mail: a0535168@gmail.com Mobile:+886-918925236 ID: johnson0535168

第一週	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	結業典禮	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	結業典禮	1.1 全球半導體產業概 況暨就業前景	1.3 積體電路設計	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	2.1 半導體制程整合 原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	

台灣半導體科技教育協會第二期課程

第二週	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	考試	
20:55~ 21:40	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	2.5 先進半導體制程控制 技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結 構及可靠度整合	考試	

台灣半導體科技教育協會第二期課程

第三週	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	休息
19:15~ 20:00	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	
20:10~ 20:55	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料 制程	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	業師輔導 互動交流	

台灣半導體科技教育協會第二期課程

第四週	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術與應用	3.3 PCB 制程簡介	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝測試設備簡介	休息
19:15~ 20:00	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術與應用	3.3 PCB 制程簡介	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝測試設備簡介	
20:10~ 20:55	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	業師輔導 互動交流	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界-入門級	業師輔導 互動交流	
20:55~ 21:40	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	業師輔導 互動交流	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界-入門級	業師輔導 互動交流	

台灣半導體科技教育協會第二期課程/第三期課程

第一週	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.1 全球半導體產業概況 暨就業前景	1.3 積體電路設計	休息
19:15~ 20:00	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.1 全球半導體產業概況 暨就業前景	1.3 積體電路設計	
20:10~ 20:55	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	
20:55~ 21:40	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	1.2 基本電子電路	1.4 IC 設計流程概論- 數位篇	

台灣半導體科技教育協會第三期課程

第二週	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	休息
19:15~ 20:00	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	
20:10~ 20:55	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	
20:55~ 21:40	2.1 半導體制程整合原理	2.2 元件物理導論	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	2.3 薄膜技術與應用	2.4 電漿蝕刻	

台灣半導體科技教育協會第三期課程

第三週	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~19:15	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	業師輔導 互動交流	休息
19:15~20:00	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	業師輔導 互動交流	
20:10~20:55	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	考試	
20:55~21:40	2.5 先進半導體制程控制技術	2.6 半導體元件物理	2.7 半導體制程，元件結構及可靠度整合	2.8 晶圓清潔技術	2.9 銅/低介電常數材料制程	考試	

台灣半導體科技教育協會第三期課程

第四週	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	休息
19:15~ 20:00	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.2 半導體材料分析技術 與應用	
20:10~ 20:55	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	
20:55~ 21:40	2.10 先進化學機械研磨	2.11 真空技術及 應用	2.12 半導體制程與封裝 入門	2.13 黃光微影制程技術	3.1 蝕刻技術	3.3 PCB 制程簡介	

台灣半導體科技教育協會第三期課程

第五週	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	10月1日
時間	週一	週二	週三	週四	週五	週六	周日
18:30~ 19:15	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界- 入門級	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	中秋節
19:15~ 20:00	3.4 SPC 統計制程式控制	4.1 漫遊 IC 封裝世界- 入門級	4.3 記憶體測試	業師輔導 互動交流	業師輔導 互動交流	結業典禮	
20:10~ 20:55	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	
20:55~ 21:40	3.5 FMEA 的觀念與應用	4.2 半導體廠務，封裝 測試設備簡介	4.4 先進電子封裝設計 導論	考試	業師輔導 互動交流	結業典禮	